

第4回レーザー先端材料加工国際会議

The 4th International Congress on Laser Advanced Materials Processing

LAMP2006

<http://www.jlps.gr.jp/lamp/lamp2006/>

2006年5月16~19日

京都リサーチパーク

(〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134番地 TEL: 075-322-7888)

LPM2006- The International Symposium on Laser Precision Microfabrication (レーザー精密微細加工国際シンポジウム)

HPL2006- The International Symposium on High Power Laser Processing (高出力レーザー加工国際シンポジウム)

主催: (社)高温学会内レーザー加工学会, (独)産業技術総合研究所, (独)理化学研究所

組織委員長: 宮本 勇 (大阪大学)

副委員長: 杉岡 幸次 (理化学研究所)

片山 聖二 (大阪大学)

Henry Helvajian, The Aerospace Corporation, USA

Friedrich H. Dausinger, Univ. of Stuttgart, Institut für Strahlwerkzeuge, IFSW, Germany

伊東 一良 (大阪大学)

▶ LAMP2006の趣旨

LAMP2006-The 4th International Congress on Laser Advanced Materials Processing (第4回レーザー先端材料加工国際会議)はLPM2006-The International Symposium on Laser Precision Microfabrication (レーザー精密微細加工国際シンポジウム), HPL2006-The International Symposium on High Power Laser Processing (高出力レーザー加工国際シンポジウム)より構成され、マイクロ加工、マクロ加工における基礎科学から産業応用までをカバーする国際会議です。口頭セッション、ポスターセッション、ならびにテーブルトップ展示を併設し、4日間の日程で開催されます。当該分野において基礎研究者、エンドユーザー、レーザーマニュファクチャラーが一堂に会し、レーザー-材料相互作用の基礎科学からレーザー加工技術の現状、次世代のレーザー加工のトピックスまで広く議論する場を提供することを目的としております。この会議を通して、レーザー加工を支える科学基盤を確立することはもとより、レーザー加工技術の実用化を制限する要因、それを克服するために必要な科学技術、将来市場の予測などが明確になることを期待いたします。当該分野にご関心をお持ちであれば、どなたでもご参加を歓迎いたします。



金閣寺



竜安寺石庭



写真提供: © 京都コンベンションビューロー

▶ LPM TOPICS

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Fundamental aspects
(Dynamics, modeling, simulation, etc.) 2. Process monitoring and control 3. Laser- and photo-chemistry 4. Nanotechnology 5. Ultra-short pulse laser processing 6. VUV laser and x-ray processing 7. Surface treatment
(Texturing, cleaning, annealing, modification, etc.) 8. Micro-patterning and micro-structuring 9. Micro-machining 10. 3-D micro- and nano-fabrication 11. Micro drilling and cutting 12. Micro welding and bonding 13. Micro forming 14. Wafer dicing 15. Marking and trimming 16. Packaging and mounting process | <ol style="list-style-type: none"> 17. Lithography
(including EUV source and application) 18. Manufacture of micro devices and systems 19. Film deposition and synthesis of advanced materials
(PLD, CVD, etc) 20. Nanomaterials synthesis 21. Optics and systems for laser micro- and nano-processing 22. Laser devices 23. Industrial applications 24. Special Session 1
The state of the art and future perspective of fs laser processing for industrial applications 25. Special Session 2
Laser-based direct-write techniques 26. Special Session 3
Laser micro/nano-engineering for biomedical applications 27. Others |
|---|---|

▶ HPL TOPICS

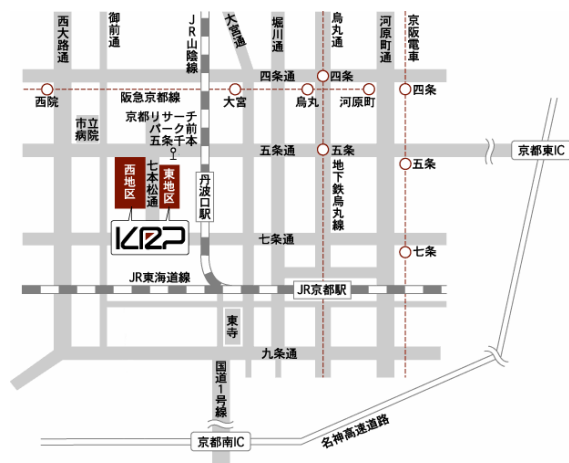
- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Fundamentals of laser-materials interactions 2. Laser-induced plasma 3. Monitoring and control 4. Modeling and simulation 5. Materials and metallurgical aspects 6. Evaluation of properties (Strength, etc.) 7. High power laser diode 8. Gas laser 9. Solid-state laser 10. Optics 11. Beam delivery system 12. Welding 13. Welding of light metals and alloys 14. Tailored-blank welding 15. Hybrid welding | <ol style="list-style-type: none"> 16. Drilling and cutting 17. Cleaning 18. Surface modification
(Quenching, alloying, etc.) 19. Cladding 20. Rapid prototyping 21. Forming and shaping 22. New and innovative applications
(Sandwich panel, etc.) 23. Applications
(Automobiles, ship, trains, airplanes, etc.) 24. Applications
(Steel, motors, parts, nuclear fields, etc.) 25. Present status and future prospects 26. Others |
|---|---|

▶ Due Dates

アブストラクト提出締切:
2005年11月30日

論文原稿の提出締切:
On-Site Submission
2006年5月16~19日 会場受付にて
CD(PDF, Word) および
出力コピーをご提出ください。

▶ 京都リサーチパークへのアクセス



レーザー加工学会 LAMP2006 事務局 (担当:寺岡)
ホームページ: <http://www.jlps.gr.jp/lamp/lamp2006/>
広告展示募集も承っております。詳細は LAMP2006 事務局まで。
TEL/FAX: 06-6879-8642, E-mail: teraoka@jlps.gr.jp